

证券代码：300184

证券简称：力源信息

武汉力源信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 公司调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u> 电话会议交流 </u>
参与单位名称及人员姓名	开源证券：傅盛盛 开源证券：刘翔 开源证券：曹旭辰 天弘基金：蔡锐帆
时间	2022年3月30日下午15:00
地点	无
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书 王晓东 副总经理兼投资总监 廖莉华
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍一下公司业务及2021年度经营状况。</p> <p>答：公司是国内第一家A股上市的电子元器件代理分销企业，2001年公司成立之初就是以代理推广8位微处理器MCU8051系列产品起家，主要是服务工业领域的中小企业，覆盖行业较多，公司以MCU为主芯片切入口附带推广其它芯片，主要专注于主动芯片技术型分销业务。公司成立第十年也就是2011年公司在深交所创业板上市，是国内第一家A股上市的电子元器件代理分销企业，在随后的2013年-2017年通过并购三家同行业优秀公司，增加了更多的优质产品线，产品从主动扩充到被动，行业从工业</p>

扩充到消费，形成了包含欧美系、国产系、日系知名上游原厂产品线覆盖，下游上万家从小到大的客户分布于上百个子行业，完成了芯片分销业务的架构整体搭建及布局。分销业务搭建完整后，公司就开始进入芯片自研，前期推出的自研芯片有 EEPROM 和 SJ-MOSFET 系列产品，为公司积累和锻炼了研发团队，并逐步跑通了半导体芯片从设计到制造的各个环节，与上游晶圆厂和封装测试厂建立了良好的合作关系。2021 年 4 季度以来新推出的两款自研 MCU 芯片已开始逐步量产，后续量产规模将逐步爬升。未来公司将形成芯片代理及芯片自研的双轮驱动。

2021 年，公司通过增加 OPPO、vivo、小米等其他手机品牌业务，大幅弥补 2020 年以来华为手机业务下降的影响，同时加大在工业及新能源、汽车、泛在电力物联网、智能仪表、无线通信等行业的投入，提高高毛利业务占比，业务结构的优化使得业务布局更加合理，客户结构更加健康，因此公司总体营业收入达 104.42 亿元，同比增长 0.79%，与 2020 年相比保持了稳定；净利润 3.06 亿元，同比增长 117.66%，整体盈利能力得以大幅提高。

2、请问公司 2021 年度各行业销售额占比情况如何？

回复：根据公司 2021 年度销售情况，通信电子销售额占比最大，约 50%；其次是工业及新能源行业，占比约 14%；消费电子占比约 9%；汽车电子约 7%；安防监控约 6%；其他业务（包括终端产品业务、SMT 代工业务及其他细分行业业务）约 14%。

3、请问公司 2022 年第一季度经营情况如何？

回复：公司 2022 年一二月销售情况良好，三月受深圳、上海疫情封控影响，会对公司经营活动略有影响。

4、请问公司自研 MCU 芯片进展如何？

回复：公司自研 MCU 在 2021 年 12 月已开始在客户群中导

	<p>入，在不同行业中都有成功的 design in，同时也收获了一些项目的 design win，目前主要在电子烟、无线充、电机控制板、储能电源、IOT 模组、小家电、手机周边等市场有所突破，陆续收到客户订单，由于量产有生产周期，目前还未开始批量出货。预计在 2022 年下半年，随着产品批量供货的稳定，以及配套的市场推广活动，公司的自研 MCU 产品将会被越来越多的客户所接受。</p> <p>5、请问公司如何看待半导体行业未来发展方向？</p> <p>回复：随着 5G、毫米波通讯、新能源汽车、光伏发电、航空航天等战略新兴产业发展，未来第三代半导体的应用需求将不断增加。公司将一方面争取上游原厂第三代半导体相关产品的代理权，将产品导入到下游客户中，加深对相关应用市场的了解与认识，另一方面也将积极寻找合适的机会，进行相关的投资。</p> <p>6、请问公司参股公司云汉 IPO 进程如何？</p> <p>回复：公司持有云汉芯城 10.25% 股权，为其第三大单体股东，2022 年 3 月 25 日深交所创业板发行上市审核信息公开网站显示云汉芯城 IPO 已完成第一轮反馈回复。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 3 月 30 日